Solder plus Support

M8 PASTA NO CLEAN

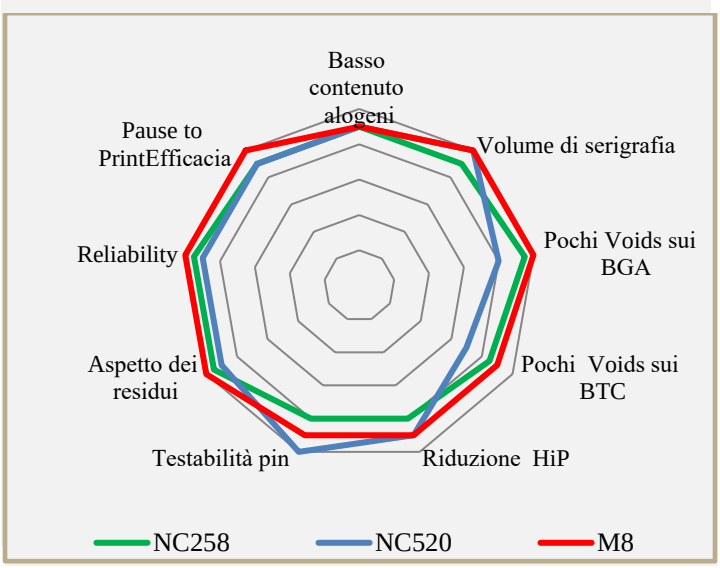
FEATURES

- Pochi voids <5% su BGA and <10% on BTC
- Eccellente efficienza in serigrafia <0,50 AR
- Elimina i difetti HiP
- Conforme a REACH e RoHS * – Esente da alogeni
- Formulata per uso con polveri T4 ed inferiori
- Ottima bagnabilità su finiture lead-free
- Minimi residui trasparenti -idonea per LED
- Passa Bono Automotive SIR Test

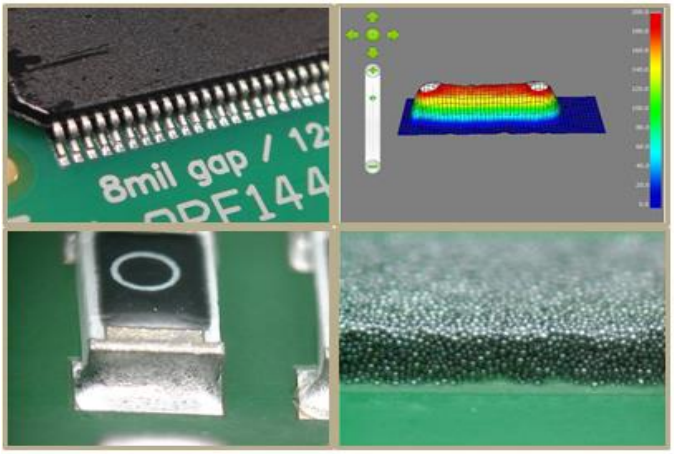
DESCRIZIONE

Sviluppata per lavorare con polveri T4 ed inferiori , sia leadfree che con piombo, M8 garantisce elevata stabilità di serigrafia anche nei componenti UFP e microBGA, riducendo la difettosità anche nelle applicazioni più complicate. Gli attivatori della M8 riducono i difetti di bagnabilità, come HiP e garantiscono saldature brillanti. M8 riduce i voids su BGA e BTC and un livello inferiore al 5% (BGA) e al 10% (BTC). M8 supera i SIR test più restrittivi del settore automotive e soddisfa i parametri dei test elettrochimici.

CARATTERISTICHE



*Leghe lead free.



MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Parametro	Tempo	Temperatura
Scadenza refrigerata e sigillata	1 anno	0°C-12°C (32°F-55°F)
Scadenza non refrigeratae	3 mesi	< 25°C (< 77°F)

Non mischiare pasta usata con pasta fresca.Stoccare la pasta usata separatamente .Mantenere la pasta non usata rigorosamente sigillata con le chiusure originali. Dopo l'apertura, la deperibilità dipende dalle condizioni ambientali e dall'applicazione. Riferirsi alle linee guida AIM per ulteriori informazioni. Lega e condizioni di stoccaggio possono influire sulla scadenza .Riferirsi al Certificato di analisi per informazioni specifiche sul prodotto.

PULIZIA

Prima del reflow: AIM DJAW-10 rimuove efficacemente la pasta M8 dalle lamine durante il processo. DJAW-10 può essere applicato a mano o usato con i sistemi di pulizia sotto alla lamina. DJAW-10 non secca la M8 e migliora la trasferibilità.Non applicare DJAW-10 sulla parte superiore della lamina, L'alcol isopropilico non è raccomandato durante il processo , ma può essere utilizzato come risciacquo finale. rin

Residui Post-Reflow: Non è necessario rimuovere i residui di M8.Nel caso fosse obbligatorio il lavaggio contattare AIM, che fornirà una tabella di compatibilità con i maggiori solventi in commercio.

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to http://www.aimsolder.com/terms-conditions to review AIM's terms and conditions.

PROFILO DI RIFUSIONE

Informazion dettagliate sul profilo possono essere trovate su http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Contattare AIM per ulteriori informazioni

SERIGRAFIA

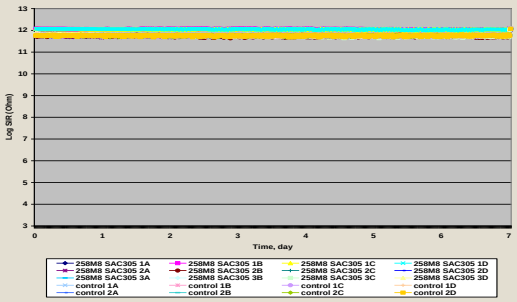
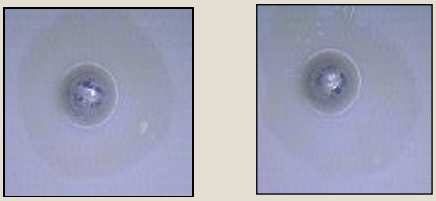
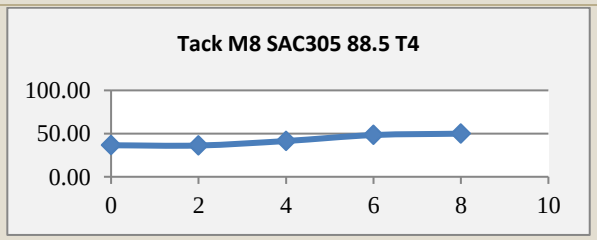
Parametri iniziali raccomandati - Dipendenti dal design del PCB e del Pad	
Parametro	valori iniziali raccomandati
Ppressione racla	0.4 - 0.7kg/25mm S
velocità racla	13 – 152 mm/secondo
Distanza Ssnap off	a contatto 0.00 mm
Distanza di separazione dal pcb	0.75 - 2.0 mm
velocità di separazione dal pcb	3 - 20 mm/secondo

RIEPILOGO DATI DEI TEST

Nome	Metodo test	Risultati	
Classificatzione flusso secondo IPC	J-STD-004	ROL0	
Classificazione del flusso secodno IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Name	**Test Method**	**Typical Results**	**Image**
Peso specifico*		4.2 gr/cm3 (SAC305)	
Copper Mirror	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BASSO	
Corrosione	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASSA	Before After
Quantitativo alogeni	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.24% Cl: 0.0% Tipici	
Qualitativo alogeni Silver Chromate	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Qualitativ alogeni, Fluoride Spot	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No fluoridi	

*Il peso specifico si riferisce solo alla SAC305.Per tutte le altre leghe contattare AIM.

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to http://www.aimsolder.com/terms-conditions to review AIM's terms and conditions.

Name	Test Method	Typical Results	Image
SIR	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	Tutte le misurazioni sui test pattern eccedono 100 MΩ	
Bono Test		PASSA Fc<8.0 Tipico	
Oxygen Bomb test alogeni	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br 265 mg/Kg Cl <122 mg/Kg	
Elettromigrazione	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASSA	
determinazione solidi non volatili	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.8% Typical	
determinazione valore acido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	136 mgKOH/g flux Typical	
Viscosità (Brookfield)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	400-1000 Kcps	
Viscosità (Malcolm)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	120 Pa.S Typical	
Visivo	J-STD-004B 3.4.2.5	PASSA	
Slump	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASSA	
Solder Ball	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASSA	 15 min 4 hrs
Tack	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Typical	

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to http://www.aimsolder.com/terms-conditions to review AIM's terms and conditions.